

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2025-026

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 288,405,986 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	铂科新材	股票代码	300811
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阮佳林	李正平	
办公地址	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301	
传真	0755-29574277	0755-29574277	
电话	0755-26654881	0755-26654881	
电子信箱	poco@pocomagnetic.com	poco@pocomagnetic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主要从事金属软磁粉、金属软磁粉芯及芯片电感等磁元件的研发、生产和销售，为电能变换各环节电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料、电感以及整体解决方案。公司通过提供解决方案服务促进产品预研与销售，满足客户在金属软磁粉、金属软磁粉芯和电感元件上的产品需求。

（二）主要产品及用途

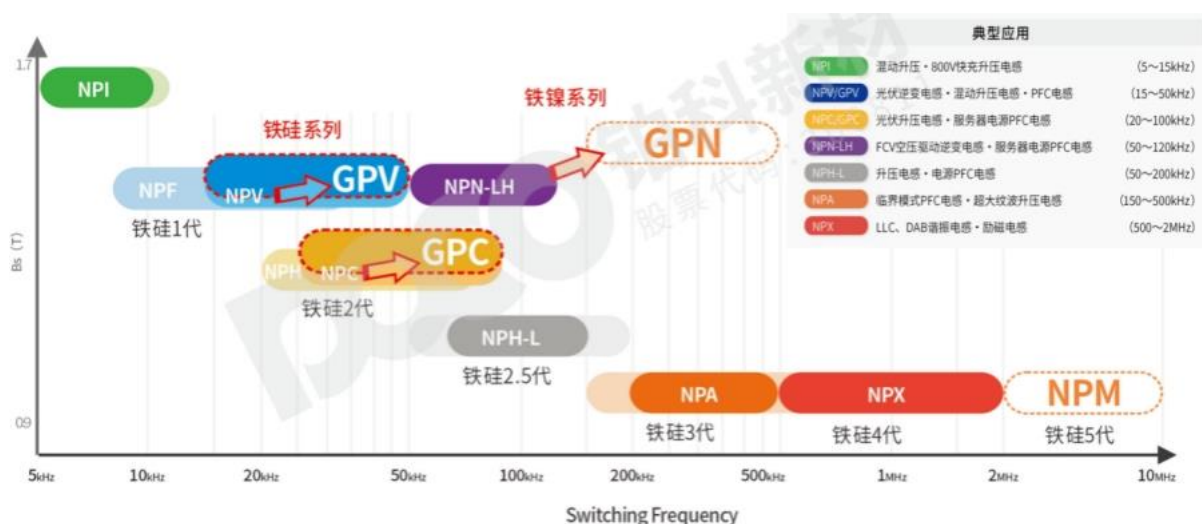


公司主要产品包括金属软磁粉、金属软磁粉芯及芯片电感等磁元件。公司产品及解决方案被广泛应用于光伏发电、新能源汽车及充电桩、数据中心（UPS、服务器电源、GPU 芯片电源）、AI、智能驾驶、储能、通讯电源、变频空调、消费电子、电能质量整治（有源电力滤波器 APF）、轨道交通等领域，属于碳中和 AI 产业链中的重要一环。

公司主要产品的具体情况如下：

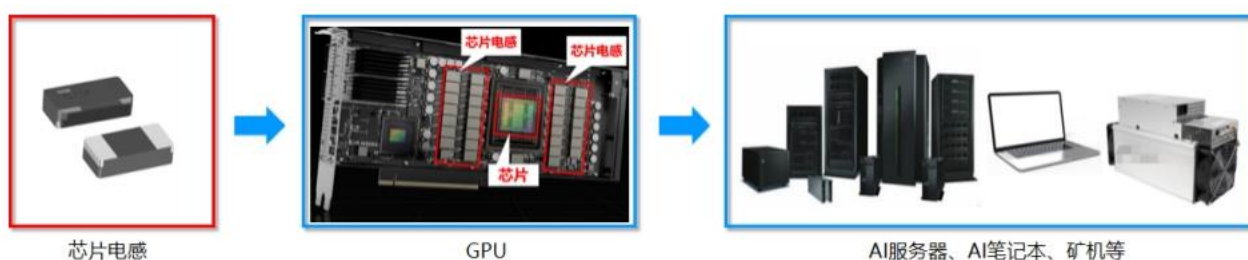
1、金属软磁粉芯

金属软磁粉芯是指将符合性能指标的金属软磁粉采用绝缘包覆、压制、退火、浸润、喷涂等工艺技术所制成的磁芯，是电感元件的核心部件之一。电感元件是用绝缘导线绕制成一定圈数的线圈，线圈内插入磁性材料所构成的电子元件。电感在电路中主要起到储能、滤波、振荡、延迟、限波等作用，此外还有过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。



公司始终以终端应用需求为产品开发导向，以精密制造工艺为支撑，从“铁硅1代”金属磁粉芯开始，不断迭代升级至“铁硅5代”，建立了一套全球领先的可覆盖 5kHz~10MHz 频率段应用的金属磁粉芯体系，可满足众多应用领域的性能需求，牢牢抓住终端用户。

2、芯片电感



基于公司在金属软磁材料产品的持续迭代和性能领先，公司针对芯片电感开发出适用开关频率可达 5kHz~10MHz 的金属软磁复合材料，为金属软磁材料进入更高频率段的半导体应用领域提供了可能性。在此基础上，公司经过多年的潜心研发，结合独创的高压成型结合铜铁共烧工艺，制造出了具有更高效率、小体积、高可靠性和大功率的芯片电感产品，

从而为芯片供电模块向小型化、高功率化方向的快速发展提供必要条件，也为公司开启了一条更加广阔的服务半导体供电领域的新赛道，并最终完成了公司**从发电端到负载端电能变换（包括 DC/AC，AC/AC，AC/DC，DC/DC）全覆盖的产品线布局，现已发展为公司的第二条增长曲线，对公司发展具有里程碑的意义。**

芯片电感起到为 GPU、CPU、ASIC、FPGA 等芯片前端供电的作用，而金属软磁材料制成的芯片电感由于具有小型化、耐大电流的特性，更加适用于 GPU、人工智能、自动驾驶、AI 服务器、AI 笔记本、通讯电源、矿机等大算力应用场景，市场前景非常广阔，主要体现在以下两个方面：

（1）随着芯片制程的不断微型化并开始向 3 纳米迈进，芯片电压越来越低，对芯片供电模块的核心元件芯片电感提出了更高的要求。前期主流的芯片电感主要采用铁氧体材质，但随着电源模块的小型化、低电压、大电流的发展趋势，铁氧体材料受限于其饱和磁通密度低等条件制约，已经很难满足后续发展需求，而基于金属软磁材料开发的芯片电感具有低电压、大电流、小体积的优势，更加符合未来大算力的应用需求。

（2）随着 AI、5G 和 IOT 时代的到来，仅靠云计算中心集中存储、统一计算或集中式的模式已经无法满足终端设备对于时效、容量、算力的需求。云边端协同方案的出现，即将 AI 算力下沉到边缘，在靠近终端用户的边缘集群进行数据本地处理，减少数据传输成本和存储成本，提高本地算力和边缘智能，处理实时性要求高的场景需求，同时边缘侧和云端数据保持同步，云端集群提供更强大的算力支撑。在这样的算力发展趋势下，越来越多的算力需求下沉到边缘和终端，意味着会需要更多的大算力芯片，以及更多的芯片电感等元件提供算力支撑。

3、金属软磁粉

金属软磁粉是指含有铁、硅及其他多种金属或非金属元素的粉末，其成分、纯度、形貌等关键指标决定了软磁材料的性能，并最终决定功率电感元件的转换效率与可靠性。公司通过十余年技术积累，已建立完整的金属软磁粉研发制造体系。在材料端，通过多组分合金设计实现高饱和磁感应强度（ $B_s \geq 1.5T$ ）与低矫顽力（ $H_c \leq 100A/m$ ）的优化组合；在工艺端，依托真空熔炼、气雾化、水雾化及高能球磨等核心技术，精准控制粉末粒径和含氧量；在应用端，形成了覆盖消费电子、汽车电子、新能源等多场景的产品矩阵，包括低损耗铁硅粉、耐大电流铁硅铬粉以及高频特性优异的非晶纳米晶粉。其中，铁硅铬粉凭借高球形度、高饱和及优异的防锈性能，已通过头部客户认证并实现进口替代，非晶纳米晶粉末的研发突破更为拓展高频应用领域奠定了坚实基础。

近年来，AI 技术的快速发展驱动消费电子、汽车电子和通信设备加速迭代升级，对电子元器件提出了小型化、高频化、高功率密度等更高要求。在此背景下，一体成型电感凭借其高感量、耐大电流、低漏磁等优势，成为满足现代电子设备高性能需求的关键元件。公司自主研发的高饱和防锈铁硅铬粉末，实现了比进口产品更高的饱和磁感应强度（ $B_s \geq 1.5T$ ）和优异防锈性能，目前已实现规模化量产，正加速推进进口替代进程。同时，公司开发的非晶纳米晶粉末凭借其独特的高频低损耗特性，已进入量产导入阶段，进一步丰富了公司在高端软磁材料领域的产品布局。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	3,079,908,959.29	2,511,722,012.35	22.62%	2,248,586,872.34
归属于上市公司股东的净资产	2,310,315,179.47	1,901,336,260.86	21.51%	1,629,094,232.30
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,662,941,446.86	1,158,519,582.05	43.54%	1,065,677,399.27
归属于上市公司股东的净利润	375,721,710.48	255,770,907.53	46.90%	193,062,125.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,825,670.36	239,254,790.61	53.32%	184,632,098.88

经营活动产生的现金流量净额	112,425,148.39	161,345,972.44	-30.32%	-5,167,544.29
基本每股收益（元/股）	1.34	0.92	45.65%	0.71
稀释每股收益（元/股）	1.34	0.92	45.65%	0.71
加权平均净资产收益率	18.00%	14.59%	3.41%	17.28%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	335,064,400.48	461,036,599.54	430,721,596.87	436,118,849.97
归属于上市公司股东的净利润	71,521,980.02	113,697,259.52	101,262,337.75	89,240,133.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,899,941.60	111,811,029.51	100,878,402.01	86,236,297.24
经营活动产生的现金流量净额	30,308,615.06	89,266,426.70	47,987,356.75	-55,137,250.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	19,740	年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数	20,014	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数	0	持有特 别表决 权股份 的股东 总数 （如 有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
深圳市摩码新 材料投资有限 公司	境内非国有 法人	23.17%	65,186,759.00	0.00	不适用	0.00			
郭雄志	境内自然人	11.13%	31,309,725.00	23,482,294.00	不适用	0.00			
罗志敏	境内自然人	5.81%	16,348,984.00	12,261,737.00	不适用	0.00			
阮佳林	境内自然人	5.63%	15,844,984.00	11,883,737.00	不适用	0.00			
杜江华	境内自然人	2.11%	5,934,650.00	4,450,987.00	不适用	0.00			
中国农业银行 股份有限公司 —交银施罗德 先进制造混合 型证券投资基 金	其他	1.84%	5,179,821.00	0.00	不适用	0.00			

广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	1.78%	5,010,118.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.56%	4,390,758.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	4,190,529.00	0.00	不适用	0.00
陈崇贤	境内自然人	1.06%	2,994,508.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中，杜江华持有控股股东摩码投资 54.00%的股权，除此之外，公司各股东之间不存在其他关联关系。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

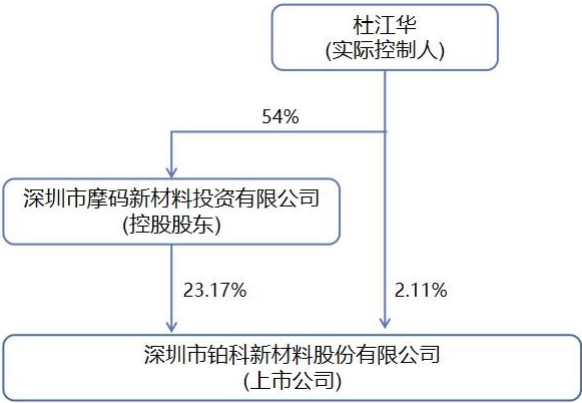
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

2024 年，公司管理团队始终秉承“让电更纯·静”的创业初心，坚持以技术开发和产品创新为核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末三条增长曲线，经营工作稳步推进。报告期内，公司**实现营业收入 16.63 亿元，同比增长 43.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.76 亿元，同比增长 46.90%，**经营业绩实现大幅增长。具体如下：

1、报告期内，金属软磁粉芯实现较快增长，实现销售收入 12.34 亿元，同比增长 20.2%，进一步巩固公司在金属软磁粉芯行业中的市场领先地位。其中，数据中心领域，得益于新基建的深入推进和人工智能的蓬勃发展，销售收入同比取得高速增长，不仅在国内市场获得高度认可，更在国际市场上赢得了众多客户的信赖，品牌影响力持续提升；新能源汽车及充电桩领域持续取得了比亚迪、华为等品牌的认可，海外市场也取得了较大突破，销售收入同比取得高速增长；光伏及储能领域由于 2024 年全球装机总量继续保持较大增长，且公司在终端的市场占比取得较大提升，销售收入同比取得较高增长；空调应用领域，公司对产品进行迭代升级，且充分发挥河源生产基地的自动化优势，使其在品质、交付、成本方面都得到大幅提升，产品市场竞争力明显加强，报告期内销售收入同比取得大幅增长。

2、报告期内，电感元件实现超高速增长，实现销售收入 3.86 亿元，同比增长 275.76%，进入了快速发展通道并爆发出强劲增长的潜力，已成长为公司业务发展规划中的主力军。在市场拓展方面，公司芯片电感产品除了与现有客户不断深化合作外，报告期内还新增进入了多家国内外知名半导体厂商供应商名录及更多应用领域（比如 ASIC 等），同时还交付了大量的样品，为后续的项目量产成功孵化打下坚实的基础。在研发方面，公司持续加大基础材料的研发力度，实现了金属软磁材料性能上的巨大突破，为公司芯片电感在更多的应用场景提供最佳解决方案打下坚实基础。在产能方面，公司持续加大投入扩充产能，为 GPU 的市场增长以及 AI PC 等应用领域的大批量供货做好准备。

3、报告期内，金属软磁粉末持续取得高速增长，实现销售收入 3,994 万元，同比大幅增长 47.31%，主要得益于新能源汽车、AI 服务器等新兴应用领域对高性能软磁材料的旺盛需求，以及公司在产品性能提升和客户拓展方面取得的显著成效。为持续巩固市场领先地位并把握行业发展机遇，公司在报告期内启动筹建年产能达 6,000 吨的现代化粉体生产基地，该项目采用“总体规划、分期实施”的建设策略：首期工程已于 2024 年建成，可新增产能 2,000 吨；全部工程计划于 2025 年竣工，最终实现产能 6,000 吨/年。该生产基地建成后，将有效缓解当前产能紧张的局面，还将为公司开拓高端应用市场提供有力支撑。

未来，随着公司金属软磁粉芯的稳步发展，芯片电感进入高速发展的快车道，金属软磁粉末产能进一步释放，公司的三条增长曲线模型构建日趋成熟，公司有信心和能力实现更大的增长目标。